

硅片多线切割技术

简介

多线切割技术是硅加工行业、太阳能光伏行业内的标志性革新，它替代了原有的内圆切割设备，所切晶片与内圆切片工艺相比具有弯曲度(BOW)、翘曲度(WARP)小，平行度(TAPER)好，总厚度公差(TTA)离散性小，刃口切割损耗小，表面损伤层浅，晶片表面粗糙度小等等诸多优点。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/8250.html>